

# 加工协议

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：北京装联电子工程有限公司

甲方委托乙方加工生产电子产品事宜，为明确双方权利及义务，确保合同顺利实施，经双方协商一致，达成本协议，约定如下：

一．加工产品名称、型号、数量、金额及交货期以每批订货合同为准。

二．加工方式

1. 甲方提供产品原材料、产品工艺文件及要求。

2. 乙方按产品工艺文件及要求加工生产。

三．双方责任

1. 甲方每批产品加工应提前7个工作日通知乙方。在正式投产前，双方须签定订货合同。

2. 甲方提供的产品原材料必须为合格材料且有可制造性，原材料包装要求为编带；甲方须提供正常原材料损耗，普通元器件损耗比例 1%，芯片、BGA 等贵重器件为零损耗。

3. 甲方必须提供完整准确的产品工艺文件及相关要求，包括产品的包装和防护要求以及特殊器件的组装要求，新产品加工应提供样板。甲方已投或欲投产品如有技术或其它更改，则应及时书面通知乙方，由此所引起的质量事故或导致乙方停产、返工等，甲方须赔偿乙方受到的相关损失。

4. 甲方应根据包装要求提供可靠的产品包装材料，否则乙方只提供临时普通包装（或周转箱），甲方应在使用完毕后完好地返还给乙方。

5. 乙方对甲方提供的产品原材料进行数量核对和来料抽检，如发现问题应及时反馈给甲方，甲方须在 24 小时内给予解决，由此造成的生产延期由甲方负责。

6. 乙方必须妥善保管甲方提供的产品原材料，不得人为损坏或丢失，除正常生产损耗和材料本身问题外的材料损失，乙方须按市场价赔偿损失材料费用。

7. 乙方必须完全按照甲方提供的工艺文件及要求编制生产工艺，并根据交货期安排生产计划，乙方必须按每批订货合同约定的交货日期交货（甲方原因造成交货期延迟的除外）。

8. 乙方在每批产品加工完毕后，除甲方声明由乙方暂管外，应及时将产品剩余材料退还给甲方，同时提供余料清单。

9.乙方未经同意不得将甲方所提供的一切工艺文件资料转借给第三方,加工过程必须遵守和保护甲方的技术秘密,否则甲方有权要求乙方赔偿因此受到的相应损失并追究其法律责任。

#### 四.产品质量及验收

1.乙方交付产品的焊接质量应符合行业标准 IPC-A-610C 的验收条件,如甲方有特殊质量要求,应随订货合同提供附件说明。

2.甲方对每批产品的验收及提出异议的期限为乙方交货后15日内,如在此期限内甲方未向乙方发出书面通知,则视为该批产品验收合格。

3.甲方在验收时如发现焊接质量问题,须保持原状并及时通知乙方,乙方应在5个工作日内予以书面答复,同时双方约定返修方式及时间。乙方未在规定期限内予以书面答复,视为接受甲方对货物的提出的异议。

4.非乙方焊接质量问题造成的不合格品,乙方不承担责任。

#### 五.运输

1.订货合同额在 1000.00 元以上的,乙方负责一次性取料送货并承担运输费用。因甲方物料不齐套的,乙方不负责再次取料(特殊情况除外)。

2.订货合同额在 1000.00 元以下的,甲方负责送料取货并承担运输费用。

#### 六.付款及结算方式

1.甲方须在乙方交货后以支票或转账方式一次性付清货款,具体付款期限以订货合同为准。

2.乙方在甲方付款同时须向甲方开具相关发票。

七.本协议书一式二份,甲乙双方各执一份。本协议自双方盖章签字之日起生效,其未尽事宜,双方经协商可签订补充协议。

甲方(盖章):

乙方(盖章):北京装联电子工程有限公司

代表人:

代表人:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日